



## 2025年3月期 第1四半期決算短信(日本基準)(連結)

2024年8月8日

上場会社名 TOWA株式会社

上場取引所 東

コード番号 6315 URL <https://www.towajapan.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 岡田 博和

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員経営企画本部長 (氏名) 中西 和彦

TEL 075 - 692 - 0251

配当支払開始予定日

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

### 1. 2025年3月期第1四半期の連結業績(2024年4月1日～2024年6月30日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期第1四半期	13,253	39.3	2,212	140.3	2,420	112.5	1,690	115.9
2024年3月期第1四半期	9,511	34.8	920	67.8	1,139	64.7	782	66.8

(注) 包括利益 2025年3月期第1四半期 2,240百万円 (10.1%) 2024年3月期第1四半期 2,491百万円 (24.3%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2025年3月期第1四半期	67.62	
2024年3月期第1四半期	31.29	

#### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2025年3月期第1四半期	87,049	59,676	68.6
2024年3月期	87,861	58,435	66.5

(参考) 自己資本 2025年3月期第1四半期 59,676百万円 2024年3月期 58,435百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2024年3月期		0.00		40.00	40.00
2025年3月期					
2025年3月期(予想)		0.00		60.00	60.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

### 3. 2025年3月期の連結業績予想(2024年4月1日～2025年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	28,700	35.0	5,650	136.5	5,650	104.4	3,960	102.2	158.41
通期	60,000	18.9	12,600	45.5	12,600	38.8	8,830	37.0	353.22

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

## 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- |                    |     |
|--------------------|-----|
| 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 | : 無 |
| 以外の会計方針の変更         | : 無 |
| 会計上の見積りの変更         | : 無 |
| 修正再表示              | : 無 |

(4) 発行済株式数 (普通株式)

期末発行済株式数 (自己株式を含む)	2025年3月期1Q	25,043,888 株	2024年3月期	25,043,888 株
期末自己株式数	2025年3月期1Q	44,592 株	2024年3月期	45,079 株
期中平均株式数 (四半期累計)	2025年3月期1Q	24,999,042 株	2024年3月期1Q	25,019,526 株

(注) 期末自己株式数には、「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式が含まれております。また、「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。

添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

## 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- 本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想等に関する詳細は、添付資料P.3「1. 経営成績等の概況(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
- 決算補足説明資料は当社ウェブサイトに掲載しております。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況 .....	2
(1) 当四半期の経営成績の概況 .....	2
(2) 当四半期の財政状態の概況 .....	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 .....	4
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 .....	6
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間 .....	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間 .....	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	8
(継続企業の前提に関する注記) .....	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	8
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記) .....	8
(セグメント情報等の注記) .....	9

## 1. 経営成績等の概況

### (1) 当四半期の経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間における世界経済は、堅調な設備投資や消費財の需要回復により緩やかに持ち直しているものの、欧米における金融政策や中東情勢などの地政学リスクを背景に先行き不透明な状況が続きました。

半導体業界につきましては、生成AIの急速な普及に伴うサーバー向け投資の需要拡大や中国の半導体内製化の動きもあり、設備投資は堅調に推移いたしました。また、需要の回復と在庫の正常化が進み、半導体メーカー各社の稼働率は徐々に改善しており、今後、設備投資の本格的な回復が期待されます。

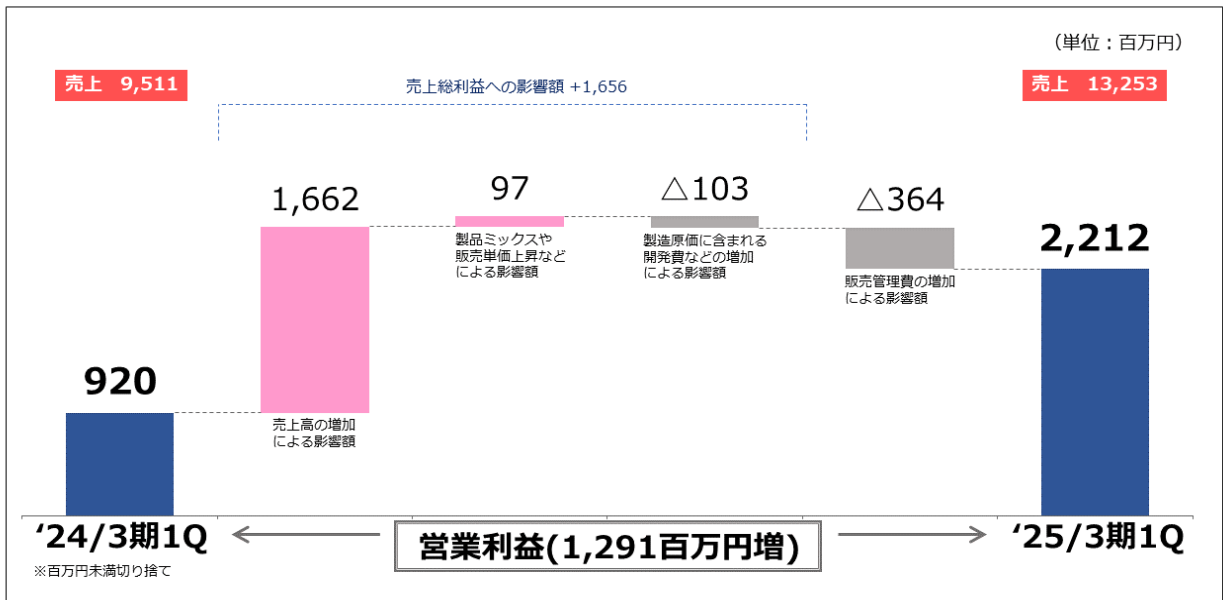
このような状況のもと、当第1四半期連結累計期間の当社グループの業績は、中国での半導体内製化に向けた投資が堅調であることや、台湾での設備投資が持ち直しつつあることから売上高は対前年同期比で増収となりました。利益につきましては、売上高の増加に伴い、各段階利益ともに対前年同期比で増益となりました。また、中国地域や韓国地域における当社独自のコンプレッション装置・金型の受注高が高い水準を維持しており、当第1四半期の連結受注高は130億75百万円（内、コンプレッション装置・金型の受注高は55億72百万円）となりました。

当第1四半期連結累計期間の経営成績は次のとおりであります。

売上高	132億53百万円（前年同期比37億41百万円、39.3%増）
営業利益	22億12百万円（前年同期比12億91百万円増、2.4倍）
経常利益	24億20百万円（前年同期比12億81百万円増、2.1倍）
親会社株主に帰属する四半期純利益	16億90百万円（前年同期比9億7百万円増、2.2倍）

当第1四半期連結累計期間の営業利益の主な増減要因（対前年同期）は次のとおりであります。

売上高の増加による影響額	16億62百万円増
製品ミックスや販売単価上昇などによる影響額	97百万円増
製造原価に含まれる開発費などの増加による影響額	1億3百万円減
販売管理費の増加による影響額	3億64百万円減



セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

[半導体製造装置事業]

半導体製造装置事業における経営成績は、中国での半導体内製化に向けた設備投資が堅調なことや、低迷していた台湾での設備投資需要が底打ちし、徐々に回復し始めていることから、売上高122億58百万円（前年同期比37億22百万円、43.6%増）となりました。利益につきましては、売上高の増加に伴い、営業利益21億64百万円（前年同期比13億69百万円増、2.7倍）となりました。

[ファインプラスチック成形品事業]

ファインプラスチック成形品事業における経営成績は、医療用の成形品や組立品の需要が堅調であることから、売上高5億69百万円（前年同期比20百万円、3.8%増）、営業利益1億26百万円（前年同期比7百万円、5.8%減）となりました。

[レーザ加工装置事業]

レーザ加工装置事業における経営成績は、事業拡大に向けた研究開発費や人件費が増加したことから、売上高は4億24百万円（前年同期比0.9百万円、0.2%減）、営業損失78百万円（前年同期は営業損失8百万円）となりました。

(2) 当四半期の財政状態の概況

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ8億12百万円減少し870億49百万円となりました。これは、棚卸資産及び固定資産は増加があった一方で、売上債権については減少があったことによるものです。

負債総額は、借入金の返済、法人税等の支払いにより、前連結会計年度末に比べ20億52百万円減少し273億73百万円となりました。

純資産は、海外事業会社の純資産の評価替えによる為替換算調整勘定の増加等により、前連結会計年度末に比べ12億40百万円増加し596億76百万円となりました。

その結果、当第1四半期連結会計期間末における自己資本比率は68.6%（前連結会計年度末比2.1ポイント増加）となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2024年5月10日の「2024年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」で公表いたしました第2四半期連結累計期間及び通期連結業績予想に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	20,830,999	21,969,548
受取手形及び売掛金	15,135,664	11,193,096
電子記録債権	345,054	385,446
商品及び製品	4,110,721	4,376,553
仕掛品	10,041,146	10,170,145
原材料及び貯蔵品	1,699,212	1,891,859
その他	1,550,660	1,333,895
貸倒引当金	△2,363	△2,429
流動資産合計	53,711,096	51,318,115
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	22,106,434	23,240,027
減価償却累計額	△13,065,298	△13,398,118
建物及び構築物 (純額)	9,041,135	9,841,908
機械装置及び運搬具	17,554,193	18,390,040
減価償却累計額	△11,954,563	△12,415,878
機械装置及び運搬具 (純額)	5,599,630	5,974,162
土地	5,289,066	6,895,574
リース資産	1,594,823	1,675,609
減価償却累計額	△440,008	△480,195
リース資産 (純額)	1,154,815	1,195,413
建設仮勘定	232,675	250,042
その他	4,852,823	5,006,426
減価償却累計額	△4,002,437	△4,149,851
その他 (純額)	850,385	856,574
有形固定資産合計	22,167,709	25,013,676
無形固定資産	1,329,271	1,347,835
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	641,147	656,097
その他	10,012,608	8,713,445
投資その他の資産合計	10,653,756	9,369,543
固定資産合計	34,150,736	35,731,056
資産合計	87,861,833	87,049,171

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2024年6月30日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,834,249	3,815,460
電子記録債務	36,252	21,680
短期借入金	9,400,000	9,400,000
1年内返済予定の長期借入金	1,560,000	1,410,000
未払法人税等	1,827,856	673,613
製品保証引当金	307,882	314,088
賞与引当金	986,299	697,691
役員賞与引当金	98,443	19,238
その他	5,146,816	5,165,803
流動負債合計	23,197,801	21,517,575
固定負債		
長期借入金	2,490,000	2,210,000
退職給付に係る負債	933,297	980,830
株式給付引当金	40,497	53,178
その他	2,764,332	2,611,560
固定負債合計	6,228,128	5,855,569
負債合計	29,425,930	27,373,145
純資産の部		
株主資本		
資本金	8,955,671	8,955,671
資本剰余金	450,981	450,981
利益剰余金	38,359,732	39,048,943
自己株式	△115,191	△113,951
株主資本合計	47,651,194	48,341,645
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	6,013,298	4,933,615
為替換算調整勘定	4,642,014	6,286,373
退職給付に係る調整累計額	129,394	114,391
その他の包括利益累計額合計	10,784,708	11,334,380
純資産合計	58,435,903	59,676,025
負債純資産合計	87,861,833	87,049,171

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
(四半期連結損益計算書)  
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
売上高	9,511,078	13,253,020
売上原価	6,393,606	8,479,218
売上総利益	3,117,472	4,773,802
販売費及び一般管理費	2,196,555	2,561,157
営業利益	920,916	2,212,644
営業外収益		
受取利息	21,633	22,016
受取配当金	63,000	53,742
為替差益	121,429	75,516
雑収入	41,996	88,963
営業外収益合計	248,060	240,239
営業外費用		
支払利息	18,136	20,322
貸与資産減価償却費	7,423	8,075
雑損失	4,135	3,818
営業外費用合計	29,695	32,216
経常利益	1,139,282	2,420,667
特別利益		
固定資産売却益	1,694	—
特別利益合計	1,694	—
特別損失		
固定資産売却損	—	98
固定資産除却損	204	2,913
投資有価証券評価損	—	6,341
特別損失合計	204	9,353
税金等調整前四半期純利益	1,140,771	2,411,313
法人税等	357,825	720,914
四半期純利益	782,946	1,690,398
親会社株主に帰属する四半期純利益	782,946	1,690,398



(四半期連結包括利益計算書)  
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
四半期純利益	782,946	1,690,398
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	680,273	△1,079,683
為替換算調整勘定	1,032,477	1,644,358
退職給付に係る調整額	△3,887	△15,003
その他の包括利益合計	1,708,863	549,671
四半期包括利益	2,491,810	2,240,070
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,491,810	2,240,070

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)
減価償却費	606,540千円	631,369千円
のれんの償却額	35,278千円	38,438千円

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前第1四半期連結累計期間（自2023年4月1日 至2023年6月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	半導体製造装置事業	ファインプラスチック成形品事業	レーザ加工装置事業	計
売上高				
(1)外部顧客への売上高	8,536,910	548,480	425,686	9,511,078
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—
計	8,536,910	548,480	425,686	9,511,078
セグメント利益又は損失(△)	795,638	133,971	△8,693	920,916

(注) セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

当第1四半期連結会計期間において、TOWA TOOL SDN. BHD. がK-TOOL Engineering Sdn. Bhd. の金型製造事業を譲り受けたことにより、「半導体製造装置事業」においてのれんが発生しております。当該事象におけるのれんの増加額は、当第1四半期連結累計期間において183,607千円です。

II 当第1四半期連結累計期間（自2024年4月1日 至2024年6月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	半導体製造装置事業	ファインプラスチック成形品事業	レーザ加工装置事業	計
売上高				
(1)外部顧客への売上高	12,258,969	569,358	424,692	13,253,020
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—
計	12,258,969	569,358	424,692	13,253,020
セグメント利益又は損失(△)	2,164,855	126,173	△78,384	2,212,644

(注) セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

各セグメントにおいて、重要な固定資産の減損損失及びのれんの金額の変動はありません。